



三井金属

2017年5月15日

各 位

## キャリア付極薄銅箔生産体制の追加増強

～生産能力を月産 330 万 m<sup>2</sup> 体制へ～

当社（社長 西田計治）は、キャリア付極薄銅箔について、生産能力を月産 330 万 m<sup>2</sup> 体制へ増強することを決定しましたのでお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した 1.5μm～5μm の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品です。1300mm までの広幅でロール出荷ができる事、ならびにキャリア剥離強度の安定性に優れている事からお客様の生産性向上と工程歩留向上に寄与できるため、高くご評価をいただいております。

MicroThin™は、2016年11月28日のプレスリリースのとおり、スマートフォンの高機能化によりスマートフォン用マザーボードなどのHDIプリント基板への適用検討が進んでおり、2018年以降も更なる需要の拡大が見込まれる事から、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）の生産体制を追加増強することとし、第二段階として、2018年7月に月産 180 万 m<sup>2</sup> 体制へ移行致します。これにより、当社の MicroThin™生産能力は月産 330 万 m<sup>2</sup> 体制となり、これまで以上に安定した供給が可能となります。

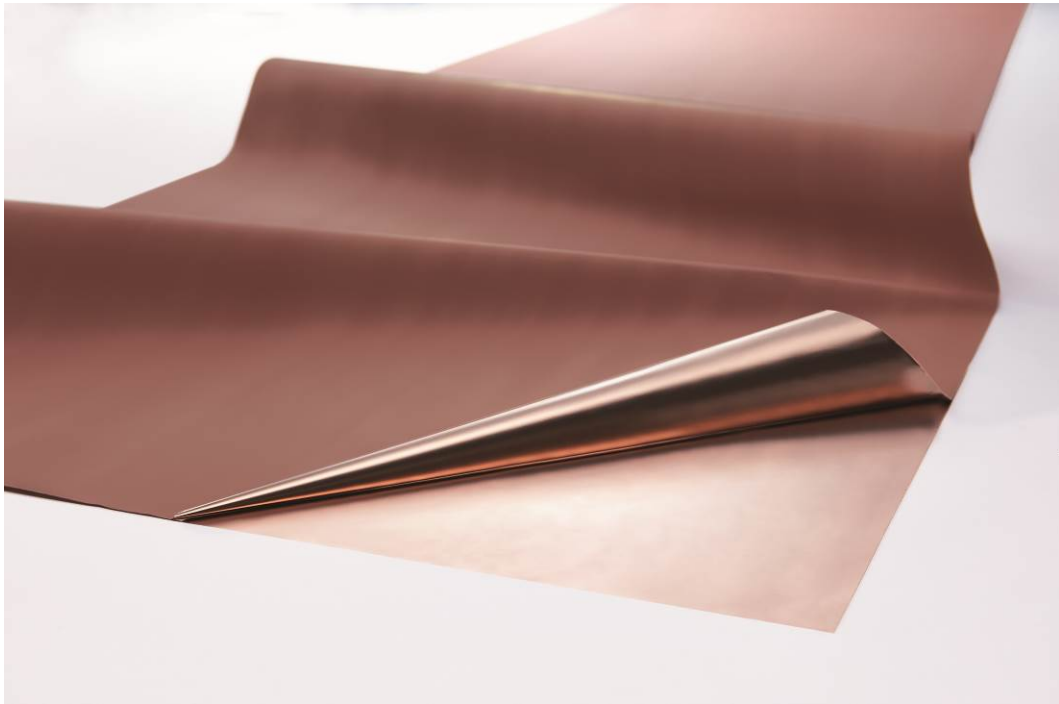
現在のパッケージ基板用途のお客様への安定した品質と十分な供給を維持するとともに、新たな用途に対しても供給体制を万全に整え、技術対応力・開発力とともに更なるお客様との緊密な連携を取り進めてまいります。また、当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、更に将来を見据えた新製品の開発を加速していく所存です。

以 上

### 【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp



キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」

(ご参考)

Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.について

- |          |   |
|----------|---|
| (1) 名称   | : Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD. |
| (2) 所在地  | : セランゴール州、マレーシア                           |
| (3) 社長   | : 手嶋 裕二                                   |
| (4) 設立   | : 1989年4月                                 |
| (5) 資本金  | : 330,000千マレーシアリングgit                     |
| (6) 出資者  | : 当社100%                                  |
| (7) 事業内容 | : プリント配線板用銅箔の製造                           |